

公益社団法人応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催
第2回 台湾-日本国際交流シンポジウム
(第12回集積化 MEMS 技術研究会 第9回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ)
開催要項

集積化 MEMS 技術研究会委員長
有本和民(岡山県立大学)

公益社団法人応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会は、集積化 MEMS 技術研究会創設 10 周年を記念する企画として、2016 年に平戸で開催された日本-台湾国際交流シンポジウムの第 2 回、例年 5 月開催の研究会および例年 7 月開催のワークショップの 3 イベントを合同とする合同研究会を台湾で開催します。台湾の MEMS 関連の国内学会(Nano-engineering and Micro-system Technology, 2018/6/1-2 (<http://www.nma.tw/>))にジョイントすることとなりました。

これまでの 5 月開催の研究会では招待講演を主とし、7 月開催のワークショップでは、研究発表とともに企業の賛助会員様からの技術紹介も行い、議論や情報交換を行うことを主な目的としてきました。また、ワークショップは企業や研究機関で開催され、参加者の研究開発に役立つ情報が得られるように開催場所の見学会を企画してきました。

今回の合同研究会は、新竹および台北にて開催します。初日の新竹にて大学および企業の見学会を予定し、二日目に台北にて研究会を開催予定です。本研究会では 1 件の基調講演と 4 件の招待講演(日本 2 件、台湾 2 件)を予定しています。講演内容は下記プログラムをご覧ください。

一般会員様からの発表は、すべてショートプレゼン(2 分予定)+ポスター形式(展示も含む)とします。なお、本合同研究会では優秀なポスターに優秀ポスター賞を授与する予定です。最後に、多くの方の投稿と参加をお願い申し上げます。

【開催日時・場所・スケジュール】

○ 見学会：平成 30 年 5 月 31 日(木)、新竹地区

- ・12:00~13:10 ランチレセプション (<https://www.facebook.com/Socratescoffe/>)
- ・13:30~17:00 新竹地区のテクニカルツアー
 - 13:30~14:30 CIC (<https://www.cic.org.tw/english/index.jsp>)
 - 14:35~15:35 NDL(<http://www.ndl.org.tw/>)
 - 16:00~17:00 ITRC (<http://www.itrc.narl.org.tw/>)

○ 研究会：平成 30 年 6 月 1 日(金)、台北地区

- ・11:20~12:00 基調講演 年吉 洋 教授(東京大学)
“MEMS Vibrational Energy Harvester for IoT Wireless Sensor Applications”
- ・12:00~13:30 休憩
- ・13:30~14:00 ポスターショートプレゼン(各 2 分予定)
- ・14:30~15:50 招待講演
 - 14:30-14:50 Dr. Ralph Tsung-Hsien Lin (TDK InvenSense Inc.)
“Miniaturized Pressure Sensor Technology through Integrated MEMS Approach”
 - 14:50-15:10 平本 俊郎 教授(東京大学)
“Advanced CMOS Devices for VLSI: Present Status and Roadmap”
 - 15:10-15:30 曾根 正人 教授(東京工業大学)
“Characteristics of Electroplated Gold Material with Multilayer Metal Technology for CMOS-MEMS Accelerometer”
 - 15:30-15:50 Prof. Tim Chih-Ting Lin (National Taiwan University)
“CMOS-NEMS Integration for Bio and Chemical Sensing”
- ・15:50~16:00 休憩
- ・16:00~17:30 ポスターセッション
- ・18:30~20:00 懇親会(Fullon Hotel, 参加無料)

【発表申込】 発表内容は、研究成果および企業による技術紹介を受け付けます。

ポスター発表の内容を指定様式の 1 ページ・サマリーに記載し、平成 30 年 5 月 17 日(木)までにメールにてお申込ください。発表言語は英語。

【参加申込】 見学会は平成 30 年 4 月 13 日(金)までに、研究会は平成 30 年 5 月 24 日(木)までに事務局(下記メールアドレス)にお申し込みください。

【参加費】 研究会会員無料、非会員 5000 円(申込を頂ければ、会員になれます)

【優秀ポスター賞】 ポスター発表、展示者から発表されたポスター及び出展のうち、特に優秀なものをポスター賞として審査に基づいて選考します。

【発表・参加申込先、問合せ先】 事務局 e-mail: integmems@lsi.pi.titech.ac.jp

申込は、下記の情報を記入後、電子メールにてお願いします。

第2回 台湾-日本国際交流シンポジウム 参加申込

氏名 _____ 所属機関 _____

電子メール _____ 電話 _____ 連絡先住所 〒 _____

集積化 MEMS 技術研究会会員(会員 / 非会員 / 学生)

見学会参加の有無(参加 / 不参加) 懇親会参加の有無(参加 / 不参加)

【宿泊申込】 研究会会場のホテル(The Fullon Hotel Taipei East)に学会特別価格(NTD 2800～)でご宿泊いただけます(5月31日～6月2日 宿泊分)。
専用の申込用紙に必要事項をご記入の上、平成30年5月18日(金)までに台湾の学会事務局までお申し込みください。期日を過ぎますと通常価格となりますので、お早めのお申し込みをお願いいたします。